

Fortsetzung Hr. Mustafa Özkök

exzellente Eigenschaften zum Einsatz in vertikalen Tauch- und Durchlaufanlagen erfolgreich entwickelt. Hierbei tritt die Eigenschaft zum schnellen Füllen von Sacklöchern in den Vordergrund unter Beibehaltung der weiteren Eigenschaften wie Duktilität und finish.

16:00 Uhr ***Pause***

16:30 Uhr ***Effiziente Umsetzung von Regeln für DFM, DFA, DFT***

Simon Zubler; Applikations-Ingenieur
FlowCAD Schweiz AG, CH-Mägenwil

Das DFM Portal von Cadence bietet PCB Designern bzw. Leiterplattenherstellern die Möglichkeit, technologiegerechte Design Regeln anzufordern bzw. bereitzustellen. Die Anwendung der Regelsätze spart Zeit beim PCB Design und reduziert die Anzahl an Iteration zwischen PCB Designer und Hersteller.

17:00 Uhr ***SAP (semi-additiv-processes); die Technologie zur Herstellung der zukünftigen Leiterplatte***

Fischer Remo, Dipl. Galvanotechniker COO
Hofstetter PCB AG, CH-Küssnacht

Die Leiterplatte der Zukunft ist um einiges feiner. Line/Space von 12-15 µm wird im Markt vermehrt ein Bedürfnis werden. Bei vielen Prozessschritten werden neue oder modifizierte Verfahren notwendig. Die veränderten Prozesshygiene-Anforderungen und deren Umsetzung beeinflussen massgeblich qualitativ hochwertige Lösungen.

17:40 Uhr ***Schlusswort***

17:45 Uhr ***Apéro mit anschliessendem Nachtessen***
und gemütlichem Beisammensein

Einladung



Schweizerische Gesellschaft
für Oberflächentechnik
Société Suisse de Traitement
de Surface

ZUM TRADITIONELLEN SGO- LEITERPLATTENSEMINAR

26. Juni 2019

Die Leiterplattenbranche – erfahren und krisenerprobt im konjunkturellen Auf und Ab früherer Jahre – konnte sich dank prosperierender Marktbedingungen konsolidieren und viele Erfolge aufweisen. Die Unternehmen liefern starke Innovationen und bedarfsgerechte Lösungen und beweisen damit, dass sie in der Lage sind, auf heimischem Terrain Entwicklungen zu präsentieren, die weltweit gefragt sind. Sie setzen dem andauernden Wettbewerbsdruck Kompetenz, Qualität, Liefertreue und Kundennähe entgegen.

Wir freuen uns auf eine spannende Tagung im Kreise der Schweizerischen und Süddeutschen Leiterplatten-Familie.

Datum: Mittwoch, 26. Juni 2019

Zeit: 13:30 Uhr

Ort: Tagungszentrum Uediker-Huus,
im Spilhöfler
8142 Uitikon ZH
(Parkplätze sind genügend vorhanden)

Kosten: Inkl. Kaffee, Apéro + Nachtessen
(ohne Getränke)

Nur Tageskasse	SGO Mitglieder	Fr. 70.-
	Nichtmitglieder	Fr. 110.-

Anmelden unter: www.sgo-sst.ch - Fachanlässe

Programm

13:30 Uhr **Begrüssung**
Hr. Peter Weber, Head of Technology
GS Swiss PCB AG, CH-Küssnacht

Marktanalyse Europa / speziell D / A / CH
Hr. Hansruedi Fischer, Verkaufsleitung D/F
Hofstetter PCB AG, CH-Küssnacht

13:45 Uhr **Innovationsführerschaft in der Digitalen Welt -
die iROI-Strategie für optimal aufgestellte Unternehmen**
Hr. Sanjay Sauldie, Direktor
Europäisches Internet Marketing Institut (EIMIA), D-Mannheim

Digitalisierung ist in aller Munde - doch welche Veränderungen sind wirklich notwendig, um ein Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen? Innovation gepaart mit dem richtigen Marketing und Integration in die eigene Digitale Strategie unterscheiden die Gewinner von heute.

Fortsetzung Hr. Sanjay Sauldie

In 7 Schritten kann es jedes Unternehmen schaffen, seine Innovationen optimal in der digitalen Welt zu erarbeiten und davon maximal zu profitieren.

Sanjay Sauldie ist einer der gefragtesten europäischen Experten zu den Themen Digitalisierung in Unternehmen und Gesellschaft. In seinen Vorträgen und Seminaren zündet er ein Feuerwerk von Impulsen aus der Praxis für die Praxis.

14:30 Uhr **„Reinwasser, das ankommt“**
Hr. Herbert Hauser, Geschäftsführer
ProWaTech AG und Hauser + Walz GmbH, CH-Flaach
Hr. Stephan Dietrich, Prozess-Ingenieur
GS Swiss PCB, CH-Küssnacht

Die Spülung der Leiterplatten mit Wasser zwischen und nach den nasschemischen Prozessschritten beeinflusst direkt die Qualität der prozessierten Leiterplatten. Anhand eines realisierten Projektes zeigt die ProWaTech AG auf, wie heutzutage hochwertiges Reinwasser erzeugt wird und vor allem wie sichergestellt wird, dass diese Wasserqualität bis zum eigentlichen Spülprozess eingehalten werden kann. Den praktischen Nutzen für den Anwender einer ganzheitlich konzipierten Lösung, stellt Herr Stephan Dietrich vor.

15:15 Uhr **Kupfer-Platingsysteme für flexible Leiterplatten**
Mustafa Özkök; Global Product Manager Panel and Pattern Plating
Atotech Deutschland GmbH, D-Berlin

Flexible Leiterplatten sind je nach Bauart mehrfach biegsam, faltbar etc. Dadurch ergeben sich besondere Anforderungen an die Kupferabscheidung. In Anbetracht dieser Forderungen wurden die Kupferelektrolyte Cupracid® Flex, InPro® Flex und zuletzt InPro® RA mit